

南通富士通微电子股份有限公司 关于收到国家科技重大专项部分资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司继承担国家“十一五”规划下的国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目（以下简称“02专项”）后，获得“十二五”02专项“高集成度多功能芯片系统级封装技术研发及产业化”项目立项批复（ZX02[2011]003号），并于2011年5月项目正式启动（立项审批情况已在公司2011年半年度报告第五节董事会报告章节中进行了披露）。

公司作为项目责任单位，与合作单位共同承担的“十二五”02专项“高集成度多功能芯片系统级封装技术研发及产业化”项目，包括系统级封装技术等5个课题，将分三年获得中央财政核定资金约13,712万元。

截至2011年12月31日，公司作为两个项目的责任单位，2011年度转拨至公司项目专用账户的中央财政资金以及地方配套资金共计7,330万元。其中，“十一五”02专项2011年度国拨资金290万元，“十二五”02专项第一批国拨资金4,500万元，省级配套资金2,540万元。公司将根据财政部核定的项目预算及与项目合作单位签订的相关协议，将合作单位的国拨及地方配套资金转拨至合作单位课题专用账户。

公司将按照《企业会计准则》等有关规定，将公司的项目资金计入递延收益，根据项目进度，逐笔转入营业外收入，预计不会对2011年损益产生影响。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2012年1月6日